

无铅焊锡膏

产品描述

本款无铅焊锡膏为 SAC305 合金搭配 INDIUM8.9HF 助焊剂,TYPE4 粒度,500G 装,焊接润湿性佳,焊点饱满牢固,适配精密电子 SMT 贴片焊接,环保高效。



◆ 产品优势

- 无铅环保,符合国际环保标准
- SAC305 合金,焊点牢固稳定性强
- TYPE4 粒度,适配精密贴片焊接
- INDIUM8.9HF 助焊剂,润湿性优异
- 500G 大容量,适配批量生产

◆ 产品结构

整体为合金粉与助焊剂均匀混合体系,TYPE4 粒度分布均匀,含高活性 INDIUM8.9HF 助焊剂,500G 密封包装,结构稳定,焊接性能均衡。

◆ 应用场景

适用于手机、电脑、消费电子等精密电子 SMT 贴片焊接,也适配工业控制板、传感器等元件焊接,环保合规,高效完成各类精密焊接作业。

◆ 产品特性

主体合金: SAC305 无铅材质
助焊剂成分: INDIUM8.9HF
粒度规格: TYPE4
焊接性能: 焊点饱满
存储性能: 密封包装

物料编码	型号	重量	包装方式
1.5.19.03.0041	SAC305	0.5kg	500g/罐

◆ 备注

HORB 设有技术热线,为您解答技术及使用相关问题。本信息据信准确,仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有